

センシング技術・次世代パッケージングコンソーシアム (SenTePack)

第1回総会・研究会 プログラム

- 1、開催日時：2025 年 6 月 13 日(金) 13：00~17：00
- 2、開催方式：会場/Online（ハイブリッド開催）
- 3、開催会場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター 別館 11 階 第1会議室
- 4、会場アクセス：<https://www.aist.go.jp/waterfront/ja/access/index.html>
- 5、プログラム：

13：00~13：20 総会

13：20~13：35（休憩 15 分）

13：35~13：40 研究会 開会挨拶 SenTePack 副会長 山下 健一

13：45~14：45

講演1「大気・海洋・環境と産業の課題解決のためのセンサ・センシング技術」

早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 上級研究員（研究院教授）高橋 桂子 様

概要：センサ・センシング技術は、ミクロからマクロの時空間スケールをもつ諸課題の解決に不可欠な役割を担っている。世界的に深刻さを増す水、食糧、資源等の課題やマイクロプラスチックなどの汚染、生物多様性維持などの諸課題を克服するためのキーとなる技術である。今後も大きなブレークスルーが期待されるセンサ・センシング技術の必要性和方向性について、皆様と考える機会にしたい。

14：45~15：45

講演2「新次元への架け橋: チップレット技術による半導体革命」

Rapidus 株式会社 エンジニアリングセンター 第五技術部 部長 久田 隆史 様

概要：本格的な AI の時代に突入し計算需要が劇的に増大している。これに対応する重要技術の一つとしてチップレット技術の重要性が高まっている。本講演では、最先端半導体でチップレットが求められる背景と、Rapidus が取り組んでいるチップレット技術の概要を紹介する。

15：45~16：15 コーヒーブレイク（名刺交換・意見交換）

16：15~16：55 2025 年度 WG 活動方針発表

16：55~17：00 研究会 閉会挨拶 SenTePack 副会長 山下 健一

お問い合わせ先：

SenTePack 事務局

国立研究開発法人産業技術総合研究所センシング技術研究部門

e-mail：M-SenTePack-ml@aist.go.jp